

# Mate 2005 第11回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」 シンポジウム《エレクトロニクス生産科学の課題と展望》参加者募集

**主催：**(社)溶接学会 マイクロ接合研究委員会  
エレクトロニクス生産科学会準備会

**共催：**(社)機械学会 エレクトロニクス実装における信頼性設計に関する研究分科会  
(社)高温学会 加工・再生研究情報委員会  
(社)日本塑性加工学会 接合・複合分科会  
レーザ加工学会  
IMS プロジェクト 環境対応次世代接合技術の開発  
大阪大学 先端科学イノベーションセンター

**協賛：**映像情報メディア学会，エレクトロニクス実装学会，応用物理学会，化学工学会，画像電子学会，軽金属学会，計測自動制御学会，高温学会，高分子学会，資源・素材学会，システム制御情報学会，情報処理学会，人工知能学会，精密工学会，電気化学会，電気学会，電気設備学会，電子情報通信学会，日本化学会，日本機械学会，日本金属学会，日本材料学会，日本シミュレーション学会，日本接着学会，日本セラミックス協会，日本塑性加工学会，日本顕微鏡学会，日本伝熱学会，日本非破壊検査協会，日本表面科学会，日本品質管理学会，日本複合材料学会，日本物理学会，日本分析化学会，日本溶接協会，表面技術協会，プラスチック成形加工学会

## 開催趣旨

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、

などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションが必要になってきています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

**日時：**平成17年2月3日(木) 8:50～17:50  
平成17年2月4日(金) 9:00～18:20

**会場：**パシフィコ横浜 会議センター  
5階(小ホール, 501,502)  
横浜市西区みなとみらい1丁目1-1  
TEL: 045-221-2121

## シンポジウム参加登録費(論文集代を含む)

○主催・共催団体登録会社	: 20,000円
○溶接学会，協賛学協会会員会社	: 30,000円
○論文口頭発表者	: 15,000円
○大学・国公立研究機関	: 10,000円
○学生	: 5,000円
○その他(一般)	: 40,000円

## シンポジウム参加申し込み方法

所定の用紙に必要な事項(申込者氏名、連絡先住所、電話番号、FAX番号など)を記入し、次の申込先にお申し込み下さい。受付次第、参加受付書を返送させていただきます。参加登録料は、現金書留、郵便振替、銀行振込のいずれかでお支払い下さい。

問合せ、申込先：

(社)溶接学会 Mate 2005 事務局

担当連絡先：

TEL : 06-6879-4166, FAX : 06-6879-4166

E-Mail : mate@casi.osaka-u.ac.jp

**参加申し込み締め切り日：**平成17年1月20日(木)

**振込先銀行：**三井住友銀行 豊中支店

口座番号：普通 No.1962097

口座名義：Mate 組織委員会 渥美 幸一郎

### シンポジウム URL

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2005.html>

### プログラム（セッション名と発表件数）

2月3日（木）8:50～17:50（18:00～ 懇親会）

#### ◆講演

「家電リサイクル技術開発動向－商品から商品へリサイクル技術の実情－」

（株）松下エコテクノロジーセンター 堤 常固）

「リサイクルのための金属分離技術」

（愛媛大学 荒木孝雄）

#### ◆プレナリーセッション

「エレクトロニクス生産科学の課題と展望」

[A-1] ソルダリングプロセス (5件)

[A-2] ソルダ特性 (5件)

[A-3] リサイクル (2件)

[B-1] デバイス実装 (4件)

[B-2] 金属フィラーによる実装 (5件)

[B-3] めっき・表面処理 (4件)

[C-1] 検査 (5件)

2月4日（金）9:00～18:20

[A-4] 反応・物性 (5件)

[A-5] 鉛フリーソルダリングⅠ (5件)

[A-6] 鉛フリーソルダリングⅡ (6件)

[A-7] 鉛フリーソルダリングⅢ (6件)

[B-4] 基板・付着強度 (5件)

[B-5] 信頼性Ⅰ (5件)

[B-6] 信頼性Ⅱ (6件)

[B-7] 信頼性Ⅲ (5件)

[C-2] 超音波接合 (4件)

[C-3] 固相接合 (4件)

[C-4] デバイス応用Ⅰ (4件)

[C-5] デバイス応用Ⅱ (6件)

（一般論文発表合計91件）